

江苏博迁新材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
参与单位名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司、敦和资产管理有限公司、福泽源（上海）私募基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、上海趣时资产管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、北京阳光天泓资产管理有限公司、招商证券股份有限公司、浙江省浙商资产管理股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、嘉信天时（香港）有限公司、北京澄明私募基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、杭州巨子私募基金管理有限公司、深圳市国诚投资咨询有限公司、招商基金管理有限公司、上海道合私募基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、杭州白犀资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、博道基金管理有限公司、太平养老保险股份有限公司、上海国泰海通证券资产管理有限公司、野村东方国际证券有限公司、广东千源私募基金管理有限公司（以上排名不分先后）
时间	2026 年 1 月
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书：蒋颖女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 主要交流内容</p> <p>问题 1：请简要介绍下公司的主营业务情况。</p> <p>公司回复：公司的主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售。目前公司产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、银包铜粉、合金粉。其中镍粉、铜粉主要应用于 MLCC 的生产，并广泛应用到消费电子、汽车电子等领域；银包铜粉产品主要用于制作光伏领域异质结（HJT）电池用低温浆料。公司的下游客户主要为 MLCC 等电子元器件生产商以及各类浆料生产商。</p>

**问题 2：当前 MLCC 行业需求的核心驱动因素有哪些？其需求变化对上游粉体材料带来了怎样的影响？**

公司回复：MLCC 行业需求正受到 AI 服务器和汽车电子两大领域的驱动，市场增长动力强劲。在汽车电子领域，高级驾驶辅助系统渗透率提升推动车规级 MLCC 向小型化、高容化、耐高压化方向发展；在 AI 服务器领域，算力需求的持续攀升推动设备对功率、电耗指标的要求同步提高，高容值、耐高温 MLCC 的单位用量随之增加。据三星电机官网显示，依托 AI 技术推广、电动汽车普及和自动驾驶系统的进化，AI 服务器与车载用 MLCC 需求预计将高速增长，每辆电动汽车所需的 MLCC 大约为 2 万至 3 万个，AI 服务器所搭载的 MLCC 则是普通服务器的十倍以上。同时，据台湾最大的被动元件代理商日电贸统计，搭载 GB200 的 NVL36 机柜约需 23.4 万颗高阶 MLCC，NVL72 机柜约需 44.1 万颗。这一趋势正在重塑 MLCC 行业的供需格局，并持续拉动对小粒径高端粉体材料的旺盛需求。

**问题 3：公司的银包铜粉产品有什么竞争优势？**

公司回复：公司银包铜粉产品主要应用于光伏领域异质结（HJT）电池低温浆料的制备，核心竞争优势体现在成本与制备工艺两大方面。从成本端来看，降低银耗是光伏行业核心降本方向，更是电池片非硅环节降本的主要驱动力，叠加现阶段银价持续上涨，贱金属替代已成行业主流发展趋势，公司产品契合行业降本需求，降本优势显著；从制备工艺来看，公司采用气相常压下等离子体加热冷凝法（PVD 法）制备用于银包铜粉中的铜核粉体，该工艺所获得的铜粉具备良好的球形度特征，有利于后续银层的均匀致密包覆。

**问题 4：公司多元合金粉体的核心应用领域是什么？目前该产品市场应用前景如何？**

公司回复：AI 算力爆发推动 GPU、CPU 等核心芯片功耗持续攀升，催生对高性能芯片电感的迫切需求。公司多元合金粉体主要应用于电

	<p>感领域，产品为亚微米级、微米级细粉，与行业主流大粒径粉体复配使用，可有效提升电感磁导率和产品稳定性。目前，公司超细多元合金粉体已向多家电感厂商送样评测，但现阶段下游客户受成本因素制约，暂未实现大规模应用，此块业务收入占比较小。随着高算力需求推动电感材料性能要求提升，公司多元合金粉体产品将有望逐步打开应用市场。</p> <p><b>问题 5：公司纳米级硅粉及硅合金粉体产品的进展如何？相关制备技术具备哪些优势？</b></p> <p>公司回复：公司开发的纳米级硅粉及硅合金粉体产品，现阶段正与下游电池、负极材料生产企业开展试样及性能评测工作，相关产品与技术的开发具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司采用气相常压下等离子体加热冷凝法（PVD 法）制备的纳米硅粉在球形度和分散性等性能方面具有较好的特性。在制备合金相硅基材料时，PVD 法更易实现。</p> <p><b>二、 风险提示</b></p> <p>公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本公告中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
附件清单（如有）	
本次交流是否涉及公司内幕信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
日期	2026 年 1 月汇总